

Title (en)

Process and apparatus for mounting micropackages on substrates.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zur Bestückung von Substraten mit Mikropacks.

Title (fr)

Procédé et dispositif de montage de micro-paquets sur des substrats.

Publication

EP 0224747 A1 19870610 (DE)

Application

EP 86115400 A 19861106

Priority

DE 3540073 A 19851112

Abstract (en)

[origin: US4868978A] A method and apparatus for equipping micropacks on a substrate wherein the micropacks are supplied on a band from a supply reel and are cut from the band in a cut-out device. As the micropack is cut, a suction pipette or suction head of a positioning device engages the micropack as it is cut so that the orientation of the cut micropack is always known. The method and apparatus may include a bending or shaping of the external contacts of the micropack prior to the micropack being cut from the band.

Abstract (de)

Zur Bestückung von Substraten mit Mikropacks (Mp) werden diese in einem Zuführmodul (Zm) in Bandform von einer Vorratsrolle (Vr) abgezogen und in einer Ausschneideeinrichtung (Ae) aus dem Band (B) ausgeschnitten. Ein Bestückkopf nimmt dann mit einer Saugpipette bzw. einem Saugpipettenadapter (Spa) die ausgeschnittenen Mikropacks (Mp) unmittelbar in der Schneidplatte (Sdp) der Ausschneideeinrichtung (Ae) auf und setzt sie dann in einer vorgebbaren Bestückposition auf dem Substrat ab. Durch die Aufnahme der Mikropacks (Mp) in der Schneidplatte (Sdp) ergibt sich eine genau definierte Ausgangsposition, welche andererseits ein zuverlässiges Positionieren in den programmierten Bestückpositionen eines Substrates ermöglicht.

IPC 1-7

H05K 13/04

IPC 8 full level

H01L 21/683 (2006.01); **H05K 13/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01L 21/6838 (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49135** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49144** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/53178** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/53191** (2015.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] US 4166562 A 19790904 - BROWN DONALD B [US], et al
- [Y] US 4079489 A 19780321 - KOWALSKI JOHN LAWRENCE, et al
- [Y] EP 0082559 A2 19830629 - PHILIPS PATENTVERWALTUNG [DE], et al
- [A] CH 624525 A5 19810731 - FAR FAB ASSORTIMENTS REUNIES [CH]
- [A] DE 3424323 A1 19850110 - SANYO ELECTRIC CO [JP], et al

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB LI

DOCDB simple family (publication)

EP 0224747 A1 19870610; **EP 0224747 B1 19910502**; DE 3679039 D1 19910606; US 4868978 A 19890926

DOCDB simple family (application)

EP 86115400 A 19861106; DE 3679039 T 19861106; US 92622286 A 19861103